



Board Type Rigid

Board structure Standard

Materials FR4

Layers 8

Laminations 1

RIGID PART

Total Thickness

1,500 mm

#	Definition	Type	Thickness
	Soldermask	SM = 0,015 mm	0,015
1	Copper	CU 35 um	0,035
	Prepreg	PP FR4 = 0,110 mm	0,11
2	Copper	CU 35 um	0,035
	CORE	IL 0,25	0,25
3	Copper	CU 35 um	0,035
	Prepreg	PP FR4 = 0,110 mm	0,11
4	Copper	CU 35 um	0,035
	CORE	IL 0,25	0,25
5	Copper	CU 35 um	0,035
	Prepreg	PP FR4 = 0,110 mm	0,11
6	Copper	CU 35 um	0,035
	CORE	IL 0,25	0,25
7	Copper	CU 35 um	0,035
	Prepreg	PP FR4 = 0,110 mm	0,11
8	Copper	CU 35 um	0,035
	Soldermask	SM = 0,015 mm	0,015